

中国半导体行业协会 中国就业培训技术指导中心

中半协〔2024〕17号

关于举办 2024 年全国行业职业技能竞赛 ——全国半导体行业职业技能竞赛的通知

各有关单位：

为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于技能人才工作的重要指示批示精神，培养更多大国工匠、高技能人才，根据《人力资源社会保障部关于组织开展 2024 年全国行业职业技能竞赛的通知》（人社部函〔2024〕41 号）部署，中国半导体行业协会、中国就业培训技术指导中心决定共同主办“2024 年全国行业职业技能竞赛——全国半导体行业职业技能竞赛”（以下简称竞赛），本次竞赛为二类职业技能大赛。现将有关事项通知如下：

一、组织机构

（一）主办单位

中国半导体行业协会

中国就业培训技术指导中心

(二) 承办单位

中关村芯生态芯片和整机企业联动发展联盟
北京赛迪网信息技术有限公司

(三) 协办单位

广州慧谷动力科技有限公司
北京赛思博通智能科技有限公司
中慧云启科技集团有限公司
深圳市物新智能科技有限公司

(四) 组织领导

竞赛成立组委会，负责竞赛的整体安排和组织管理工作，组委会成员由主办单位和有关单位相关负责同志担任。组委会下设办公室，具体承担竞赛的组织安排和日常管理工作。办公室设在中关村芯生态芯片和整机企业联动发展联盟。

二、赛项设置

竞赛设半导体分立器件和集成电路装调工、智能硬件装调员、计算机程序设计员 S、半导体芯片制造工四个赛项，均为单人赛。

三、竞赛内容

竞赛内容由理论考试和实际操作两部分组成，总成绩中，理论考试占 20%，实际操作占 80%。具体赛程及要求由竞赛组委会办公室另行通知。

四、竞赛组织方式

(一) 竞赛分组

各赛项设置职工组（含教师）和学生组两个组别。

(二) 报名条件

具有各赛项相关职业工作经历的企业在职人员，从事相关专业工作的高等院校、职业院校(含技工院校，下同)在职人员，以及高等院校、职业院校相关专业全日制在籍学生均可报名参赛。

已获得“中华技能大奖”“全国技术能手”称号及已通过竞赛获取“全国技术能手”申报资格的人员，不以选手身份参赛。具有全日制学籍的在校创业学生不以职工身份参赛。

(三) 竞赛方式

1. 竞赛方式

竞赛分为选拔赛和决赛两个阶段。选拔赛由各省（自治区、直辖市）在竞赛组委会和办公室的统一指导下，组织选拔赛，选拔优秀选手并以省份为单位组队，向竞赛组委会办公室报名参加决赛。决赛由竞赛组委会统一组织实施。

2. 竞赛时间地点

各赛项决赛于2024年11月举行。半导体分立器件和集成电路装调工赛项决赛在江苏省徐州市举办；智能硬件装调员赛项决赛在广东省深圳市举办；计算机程序设计员赛项决赛在四川省泸州市举办；半导体芯片制造工赛项决赛在广东省广州市举办。具体时间及地点由组委会办公室另行通知。

五、奖励办法

有关奖励办法具体内容另行通知。

六、有关要求

(一) 请有意向举办选拔赛的单位于9月10日前指定1名联系人,并将联系人信息(姓名、单位、职务、联系方式)反馈至竞赛办公室指定邮箱。

(二) 各相关单位要高度重视,精心备赛。通过竞赛鼓励和引导广大职工和学生钻研技术,加强学习,提升技能。

(三) 请各相关单位按照本通知要求,结合实际情况,成立相应的竞赛组织机构,科学制定竞赛安全工作方案和现场应急处置预案。根据消防安全规定,配置赛场消防设施设备,认真做好火、电、气以及化学品等使用管理工作,确保各项职业技能赛事活动安全有序开展。

七、联系方式

联系人:张靖、崔力心

联系电话:010-88558933、88558901

电子邮箱:hangsai@staff.ccidnet.com

通讯地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦(邮编:100048)

附件:2024年全国行业职业技能竞赛——全国半导体行业职业技能竞赛组委会名单

